

QSFP-DD (倍密度) 相互接続システム & ケーブルアセンブリー

molex

QSFP-DD相互接続システムは、8レーンの電気信号インターフェースで構成し、伝送能力最大28 Gbps NRZまたは56 Gbps PAM-4、8レーン合計では最大200または400 Gbpsの性能を実現した製品です。QSFP相互接続システムと同一フットプリントを維持することで下位互換性も備えています。

特徴・利点

28 Gbps NRZおよび56 Gbps PAM-4ケーブルアセンブリー

Temp-Flexケーブルテクノロジー

電氣的性能を飛躍的に向上。
製造効率の改善により高い利益率、
リードタイム短縮、エンドユーザー側の
コスト最小化を実現

AWG 32、30ケーブル

最長5.0mであらゆる業界の
アプリケーションニーズに
対応。コスト効率と
リードタイムを改善

完全一体化設計

コンポーネント (バックシェル、ケーブル、
配線基板) は全てモレックス製。
高品質コンポーネントをコスト効率に優れた
包括的ソリューションで統合

IEEE 802.3bj、InfiniBand EDR、SAS 3.0の各規格に準拠

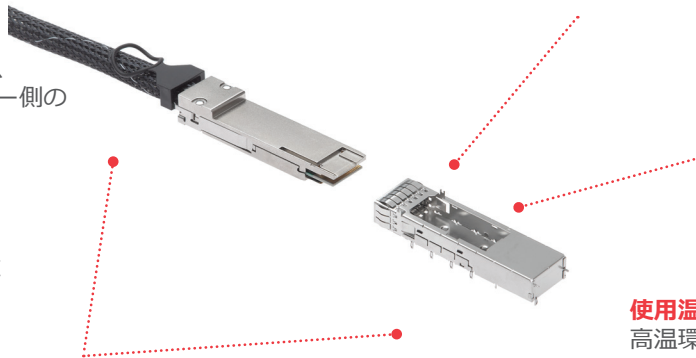
多様な次世代テクノロジーおよびアプリケーションに対応する
機能を搭載

倍密度

高速通信に対応する
2列の拡張パドルカード

使用温度範囲: 20 ~ +85°C

高温環境下でも使用可能



特徴・利点

シートメタル (ステンレス鋼製) EMIケージ (203143、203152、203369、203370、203371、203372シリーズ)

スタック一体型コネクタ & ケージ

2 by 1構成オプションにも対応

プラグブルアプリケーションをサポート

ステンレス鋼製ケージ

銅合金素材よりも優れた堅牢性

QSFP+コネクタと同一形状の

嵌合インターフェースで下位互換性を維持

現行QSFP+

インフラストラクチャを使用可能

ナローエッジカップリング、ブランク型、

成型コンタクト形状、および

インサートモールドを使用したカップリング設計

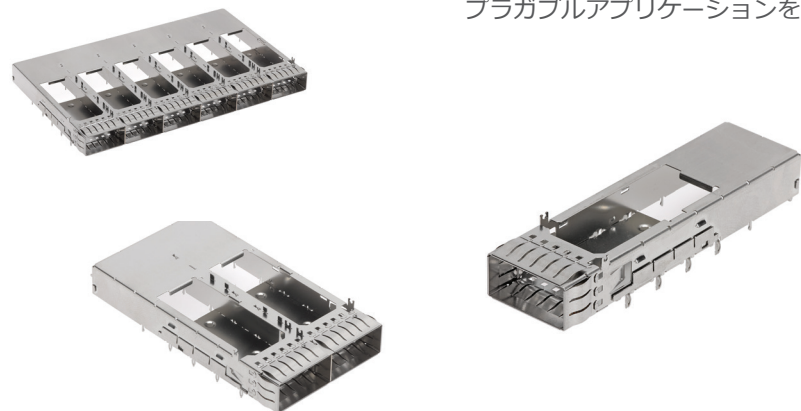
超低挿入損失 (IL) 等

優れた信号整合性 (SI) を実現

ニッケルメッキヒートシンク

モジュールからヒートシンクへの

熱伝導率が向上



QSFP-DD (倍密度) 相互接続システム & ケーブルアセンブリー

molex

特徴・利点

QSFP-DD SMT (202178シリーズ) および
スタック一体型コネクタ & ケージ (204058シリーズ)

表面実装 (SMT) タイプ
(202718シリーズのみ)
PCB両面への実装も可能

28 Gbps NRZおよび56 Gbps PAM-4

現行の200ギガビットEthernetやInfiniBand
100ギガビット (EDR) アプリケーション
で求められる仕様を上回る伝送能力。
従来の10 Gbps Ethernet、14 Gbps (FDR) InfiniBand
および16 Gbpsファイバーチャネル
アプリケーションにも対応



メタル製EMIガスカート内蔵 スタック構造の集積型コネクタ (171722シリーズ)

優れたEMI遮蔽性能を実現

ナローエッジカップリング、ブランク型、
成型コンタクト形状、および
インサートモールドを使用したカップリング設計
最大周波数14 GHz下で0.8 dB未満の超低挿入損失 (IL)
を達成する等、優れた信号整合性 (SI) を実現

EMIケージ直下に配置された
0.80mmピッチホストコネクタ
ホットプラグ対応アプリケーションに使用可

アプリケーション

通信機器

- サーバー
- ルーター
- スイッチ
- セントラルオフィス
- セルラー通信用インフラ
- マルチプラットフォームサービスシステム

データネットワーキング機器

- サーバー
- ストレージ



サーバー

仕様

28 Gbps NRZおよび56 Gbps PAM-4ケーブルアセンブリー

参考情報

梱包形態: 電磁波シールド袋

電気的性能

周波数範囲: 10 MHz ~ 25 GHz
IF帯域幅: TBD
供給電圧: TBD
供給電流: TBD
消費電力: TBD

機械的性能

耐久挿抜回数:

PL1 (パフォーマンスレベル1):
0.38μm 金メッキ: 50回、5年使用時
(混合ガス流試験なし)
PL2 (パフォーマンスレベル2):
0.76μm 金メッキ: 250回、10年使用時
(14日間混合ガス流試験)

材質

バックシェル: 亜鉛ダイキャスト
ケーブル接続部: ナイロン
ラッチ: ステンレス鋼
ケーブル: 8ペア、100Ωディファレンシャル、
CL2規格対応
RoHS: TBD
使用温度範囲: TBD
非使用時温度範囲: TBD

QSFP-DD (倍密度) 相互接続システム & ケーブルアセンブリー

molex

仕様

SMTコネクタ

参考情報

梱包形態: エンボステーピング
ULファイルNo.: TBD
CSAファイルNo.: TBD
嵌合相手: 銅ケーブルアセンブリー
倍密度SMTは201591シリーズと嵌合
寸法単位: mm

電気的性能

最大定格電圧: 30V
最大定格電流: TBD
接触抵抗: TBD
耐電圧: TBD
絶縁抵抗: TBD

機械的性能

ハウジングの端子保持力: TBD
嵌合力: TBD
抜去力: TBD
耐久挿抜回数: TBD

材質

ハウジング: 耐熱性プラスチック
ガラス充填、UL 94V-0、黒
コンタクト: 銅合金
メッキ:
コンタクトエリア: 0.76μm 金
半田付け部: 錫
下地メッキ: ニッケル
RoHS: 申請中
使用温度範囲: TBD

スタック型コネクタ & ケージ

参考情報

梱包形態: トレイ
ULファイルNo.: TBD
嵌合相手: 銅ケーブルアセンブリー
(201591シリーズ)
寸法単位: mm

電気的性能

最大定格電圧: 30V
最大定格電流: 0.5A、電源コンタクト: TBD
接触抵抗: TBD
耐電圧: TBD
絶縁抵抗: TBD

材質

ハウジング: 耐熱性プラスチック
ガラス充填、UL 94V-0、黒
コンタクト: 銅合金
メッキ:
コンタクトエリア: 0.76μm 金
テールエリア: 錫 / 鉛
下地メッキ: ニッケル
RoHS: 準拠 (適用除外による)
使用温度範囲: TBD

機械的性能

嵌合力: 0.75N (1極あたり)
抜去力: 0.25N (1極あたり)
耐久挿抜回数: 100回
(0.76μm金メッキの場合)

EMIシート - メタルケージ

参考情報

梱包形態: トレイ & ボックス
嵌合相手: QSFP+ケーブルアセンブリー
(74757、111040シリーズ)
QSFP+ ループバックアダプター
(74763シリーズ)
zQSFP+ ケーブル (111114シリーズ)
QSFP+ 倍密度ケーブルアセンブリー
(201591シリーズ)
適合相手: コネクタ (202718シリーズ)
寸法単位: mm

機械的性能

耐久挿抜回数:
基板挿入
1 by 1 嵌合力: TBD
1 by 1 抜去力: TBD
1 by 6 嵌合力: TBD
1 by 6 抜去力: TBD

材質

メッキ: ニッケル
シートメタル: ステンレス鋼
ヒートシンク: アルミニウム
ヒートシンク仕上げ: ニッケル
使用温度範囲: TBD

オーダーインフォメーション

シリーズ番号	コンポーネント	ポート構成	列数	Poles
203143	EMIケージ	1 by 1	1列	5-Poles電源
203152		1 by 2		
203369		1 by 3		
203370		1 by 4		
203371		1 by 5		
203372		1 by 6		

シリーズ番号	コンポーネント
204058	スタック型ケージ
202718	SMTコネクタ

www.molex.com/link/qsfpdd.html
www.japanese.molex.com/link/qsfpdd.html

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。